

P-165 はやぶさ2 再突入カプセルの開発

〇吉原圭介,山田哲哉,山田和彦,下田孝幸(JAXA)

概要

はやぶさ2の再突入カプセルは、開発スケジュールおよびコストに係わる厳しい制約のもと、初号機に対してシステム としての信頼性を向上させるため、初号機帰還カプセルの分析(アブレータ、パラシュート)および、はやぶさ2の新たな 設計条件(環境条件、設計基準、安全要求等)の適用評価を詳細に行った上で.

- 1) 基本となる機体設計(空力形状,主構造等)は初号機の設計を踏襲
- 2) ヒートシールド材料の再評価.
- 3) 搭載機器使用部品の信頼性向上
- 4) パラシュート開傘トリガの機能冗長化
- 5) 地上検証試験の充実

などの方針により開発を行った。また、工学データ取得を目的として再突入中の環境および機体運動の計測を行う機能を 新たに追加搭載した。本発表では以上に述べたアプローチを踏まえた はやぶさ2 CPSLの開発結果を報告する。

信頼性向上へのアプローチ

はやぶさ2の至上命題である信頼性の向上のため、新たに規定された設計標準 等への適合性評価や帰還カプセル ヒートシールドのpost flight analysisの結果を 含めてCPSL全系の設計の再確認を行った。その上で、技術リスクや重量や形状 といった物理的な制約や開発期間やコストなどのマネジメント上の制約も考慮し, 設計上の改良を施す項目を選定した.改良点の例を以下に示す.

- CPSL搭載機器の使用部品の高信頼性部品への置き換え. 一般部品の使用が必 要な場合には、十分なロット品質確認試験・スクリーニング試験等の実施。 (加速度センサについては、上記に加えて複合環境での特性試験も実施)
- ・パラシュート開傘トリガの機能冗長化(加速度センサによるトリガ+独立し たタイマによるトリガ:下図参照)
- SCIにおける開発中の不具合を踏まえた分離プーラの燃焼ガス漏洩防止処置



地上検証(解析・試験)の充実

◆ 再突入運用ワーストケース解析

再突入中に高熱に晒されるヒートシールドの損耗や温度上昇を評 価するためのアブレーション解析に加え、ヒートシールド内の温度 勾配に起因する熱変形や、再突入中に受ける圧力(動圧)に対する ヒートシールドの強度評価、カプセル内部の重要部位(サンプルを 収納するエリアや制御回路)の温度上昇について、より緻密な検討 を行い、安全に再突入が可能な軌道(経路)の範囲を明確にした.



新機能の追加(再突入飛行計測モジュール: REMM)

再突入の加熱環境やそれに対するヒートシールド設計、希薄流~低亜音速域の 広い領域での空力安定性を有する機体設計の妥当性を評価するため、はやぶさ2 CPSLでは、再突入中の各部の温度ならびに機体運動を計測するための機能を追 加した. REMM(Reentry flight Environment Measurement Module: 再突 入飛行計測モジュール)はこのために新たに開発された.厳しい質量制約のもと, 約70g(一次電池除く)に必要な機能を詰め込んでいる.





◆ CPSL FMを用いた50G試験

CPSLの総合的な機能性能試験の一環として,加速度センサによるパラシュート開傘トリ ガ機能を含むシーケンス動作の全体の確認を行うことを目的とした50G試験を実施した. 構造機能試験棟のスピンテーブルを用いて,機体に印加される加速度(減速)環境下におい て、CPSLの構造体に問題が無いこと、および、搭載機器が健全に動作することを確認した.



◆ CPSL分離試験

CPSLの分離特性(分離による姿勢擾乱)をより詳細に把握するため、分離接手および分離 スプリングを用いた分離試験を実施し、分離機構の健全性および姿勢擾乱に対する要求を 満足することを確認した.

接手分離試験

- マルマンバンド挙動(解放後の2度打ち)と姿
- 勢擾乱への影響評価 火工品発火による、サンプラシール部への 衝撃入力の評価
- 分離スプリング特性試験
- CPSL重心ずれや、分離スプリング/CPSL 本体I/F部の摩擦特性の変化に対する分離特 性の感度評価
- 上記を含めたスプリング特性の総合評価



接手分離試験コンフィグレーション

背面ヒートシールド(パラシュートカバーと一体) サンプラコンテナ



はやぶさ2 CPSLの構成

(Carbon Phenolic)